



(21) 申请号 202420151920.2

(22) 申请日 2024.01.22

(73) 专利权人 淮安市洪曦新型建材有限公司
地址 223200 江苏省淮安市淮安区石塘镇
十里村马庄组88号

(72) 发明人 谭杰 黄伟 林建永

(74) 专利代理机构 北京凯谦巨邦专利代理事务
所(普通合伙) 32303
专利代理师 刘帅

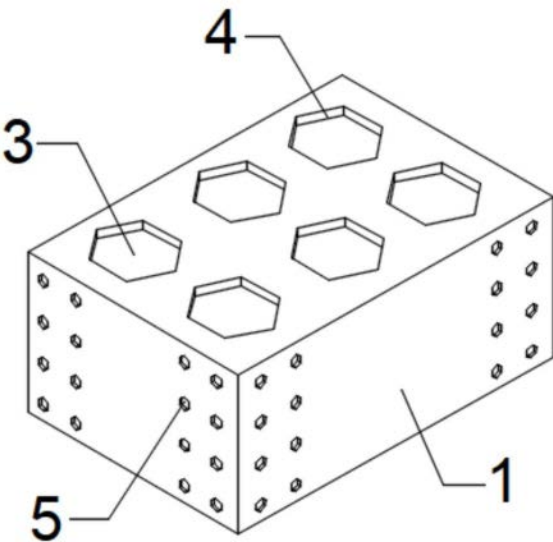
(51) Int.Cl.
E04B 2/14 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称
一种使用强度高的保温砖

(57) 摘要

本实用新型公开了一种使用强度高的保温砖,包括混凝土pc砖、隔温通孔和填充孔,还包括填充块、凹槽和混凝土预留孔,所述混凝土pc砖上等距离垂直贯穿开设有隔温通孔,所述隔温通孔的顶部和底部且位于混凝土pc砖内分别设置有填充孔,所述隔温通孔的顶部和底部且位于填充孔内均填充有硬质聚氨酯发泡块,所述硬质聚氨酯发泡块的高度小于填充孔内的高度。通过混凝土pc砖、隔温通孔、填充孔、填充块、凹槽和混凝土预留孔组成的组件,实现为人员提供一种连接强度高的保温性砖块,解决现有表面为平面的保温砖砌墙期间,相邻的保温砖连接性不高,易松动的问题。



1. 一种使用强度高的保温砖,包括混凝土pc砖(1)、隔温通孔(6)和填充孔(2),其特征在于,还包括填充块(3)、凹槽(4)和混凝土预留孔(5),所述混凝土pc砖(1)上等距离垂直贯穿开设有隔温通孔(6),所述隔温通孔(6)的顶部和底部且位于混凝土pc砖(1)内分别设置有填充孔(2),所述隔温通孔(6)的顶部和底部且位于填充孔(2)内均填充有硬质聚氨酯发泡块(3),所述硬质聚氨酯发泡块(3)的高度小于填充孔(2)内的高度。

2. 根据权利要求1所述的一种使用强度高的保温砖,其特征在于:所述硬质聚氨酯发泡块(3)端部与填充孔(2)之间的高度差形成凹槽(4)。

3. 根据权利要求1所述的一种使用强度高的保温砖,其特征在于:所述混凝土pc砖(1)两侧和两端分别内凹设置有混凝土预留孔(5)。

4. 根据权利要求3所述的一种使用强度高的保温砖,其特征在于:所述混凝土预留孔(5)分别位于两侧和两端的拐角处。

一种使用强度高的保温砖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保温砖技术领域,特别涉及一种使用强度高的保温砖。

背景技术

[0002] 保温砖是使用高分子材料合成的一种新型建材,保温砖可替代瓷砖的新型产品,主要适用于卫生间,厨房,电视背景墙,卧室,外墙等。

[0003] 现有保温砖主要有轻质粘土、轻质高铝、硅质等,但砖体的表面普遍为平面,在配合混凝土砌墙时,砖与砖之间的粘结力较低,造成墙体的使用强度较低。

[0004] 基于现有建筑保温砖存在以下弊端:砖体缺乏增加混凝土粘结效果的结构,造成墙体的使用强度较低。为此,我们提出一种使用强度高的保温砖。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种使用强度高的保温砖,可以有效解决背景技术中的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0007] 一种使用强度高的保温砖,包括混凝土pc砖、隔温通孔和填充孔,还包括填充块、凹槽和混凝土预留孔,所述混凝土pc砖上等距离垂直贯穿开设有隔温通孔,所述隔温通孔的顶部和底部且位于混凝土pc砖内分别设置有填充孔,所述隔温通孔的顶部和底部且位于填充孔内均填充有硬质聚氨酯发泡块,所述硬质聚氨酯发泡块的高度小于填充孔内的高度。

[0008] 进一步地,所述硬质聚氨酯发泡块端部与填充孔之间的高度差形成凹槽。

[0009] 进一步地,所述混凝土pc砖两侧和两端分别内凹设置有混凝土预留孔。

[0010] 进一步地,所述混凝土预留孔分别位于两侧和两端的拐角处。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:通过混凝土pc砖、隔温通孔、填充孔、填充块、凹槽和混凝土预留孔组成的组件,实现为人员提供一种连接强度高的保温性砖块,通过隔温通孔的设置,使通过混凝土pc砖砌设的墙体内部具备数个隔温通孔,从而大大降低墙体内外热量的传导,通过填充孔的设置,以及硬质聚氨酯发泡块对填充孔内的填充,实现对隔温通孔顶部和底部的封堵,避免后期砌墙时铺填的水泥砂浆渗入隔温通孔内,造成混凝土的浪费和影响隔温通孔的隔温,通过混凝土预留孔的设置,助于混凝土能够渗入砖体的顶面和地面,使上下叠落的混凝土pc砖之间的结合性更好,通过混凝土预留孔的设置,能够使混凝土pc砖砌墙时,两侧相邻的混凝土pc砖之间的连接强度更高,进而提高混凝土pc砖砌好的墙体的使用强度,解决现有表面为平面的保温砖砌墙期间,相邻的保温砖连接性不高,易松动的问题。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种使用强度高的保温砖的整体结构示意图。

- [0013] 图2为本实用新型一种使用强度高的保温砖的混凝土pc砖结构示意图。
- [0014] 图3为本实用新型一种使用强度高的保温砖的混凝土pc砖俯视结构示意图。
- [0015] 图4为本实用新型一种使用强度高的保温砖的硬质聚氨酯发泡块结构示意图。
- [0016] 图中:1、混凝土pc砖;2、填充孔;3、硬质聚氨酯发泡块;4、凹槽;5、混凝土预留孔;6、隔温通孔。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0018] 如图1-4所示,一种使用强度高的保温砖,包括混凝土pc砖1、隔温通孔6和填充孔2,还包括硬质聚氨酯发泡块3、凹槽4和混凝土预留孔5,所述混凝土pc砖1上等距离垂直贯穿开设有隔温通孔6,所述隔温通孔6的顶部和底部且位于混凝土pc砖1内分别设置有填充孔2,所述隔温通孔6的顶部和底部且位于填充孔2内均填充有硬质聚氨酯发泡块3,所述硬质聚氨酯发泡块3的高度小于填充孔2内的高度,所述硬质聚氨酯发泡块3端部与填充孔2之间的高度差形成凹槽4,所述混凝土pc砖1两侧和两端分别内凹设置有混凝土预留孔5,所述混凝土预留孔5分别位于两侧和两端的拐角处。

[0019] 需要说明的是,本实用新型为一种使用强度高的保温砖,工作时,砖体砌设人员通过混凝土pc砖1进行砌设工作时,工人先行将混凝土对砖体表面进行涂抹,随后将混凝土pc砖1之间叠落砌设,通过混凝土预留孔5的设置,助于混凝土能够渗入砖体的顶面和地面,使上下叠落的混凝土pc砖1之间的结合性更好,通过混凝土预留孔5的设置,能够使混凝土pc砖1砌墙时,两侧相邻的混凝土pc砖1之间的连接强度更高,进而提高混凝土pc砖1砌好的墙体的使用强度,通过隔温通孔6的设置,使通过混凝土pc砖1砌设的墙体内部具备数个隔温通孔6,从而大大降低墙体内外热量的传导,通过填充孔2的设置,以及硬质聚氨酯发泡块3对填充孔2内的填充,实现对隔温通孔6顶部和底部的封堵,避免后期砌墙时铺填的水泥砂浆渗入隔温通孔6内,造成混凝土的浪费和影响隔温通孔6的隔温。

[0020] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

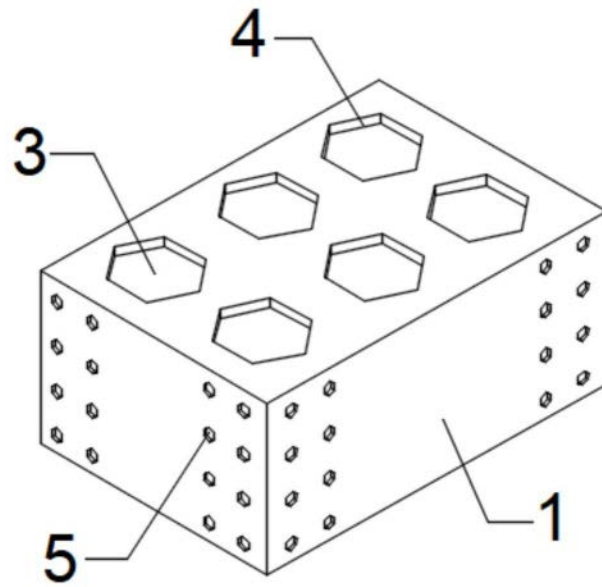


图1

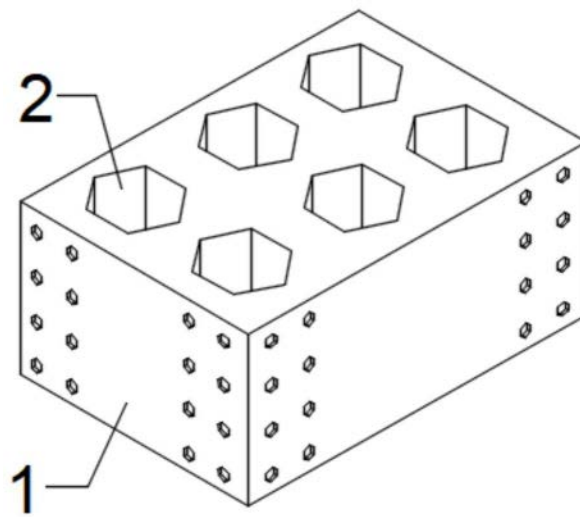


图2

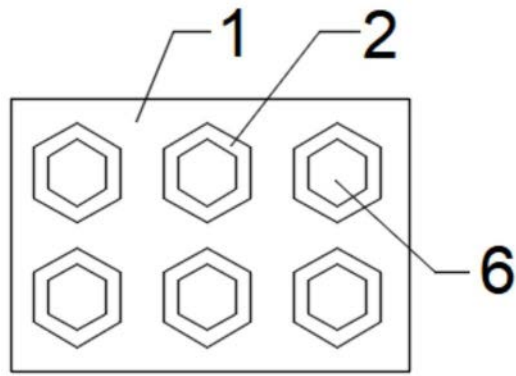


图3

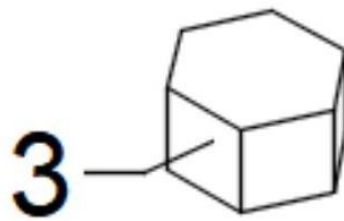


图4